附件1

**2024年“中国芯”优秀产品征集活动**

**年度重大创新突破产品申报表**

**企业信息（以下信息均为必填项）**

|  |  |
| --- | --- |
| **企业名称****（中英文）** |  |
| **企业简介** |  |
| **企业销售额** | **2023年** |  | **2024年****（上半年）** |  |
| **联系人姓名** |  | **职务** |  |
| **地址** |  | **邮编** |  |
| **座机电话** |  | **手机** |  |
| **E-mail** |  | **传真** |  |
| **企业人员规模** | **2023年** |  | **2024年****（上半年）** |  |
| **现有人员学历情况占比** | （大专及以下、本科、硕士、博士占比情况） |
| **企业规模分类** | □大型 □中型 □小型 |
| **是否为“专精特新”企业** | □是（□国家级 □省级） □否 |
| **融资轮次** |  |
| **外扩发展** | □是 □否 |

**申报产品信息（以下信息均为必填项）**

|  |  |
| --- | --- |
| **申报产品名称及型号/推出时间** | 名称：型号：推出时间： |
| **产品应用场景分类** |  □消费级 □工业级 □车规级 □其他：  |
| **申报产品的知识****产权归属** | * 属于申请单位
* 属于母公司
* 其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（请注明）
 |
| **芯片概述** |  |
| **芯片体系结构图** |  |
| **封装形式** | 封装厂 |  | 封装/生产工艺 |  |
| **生产工艺** | 代工厂 |  | 生产工艺 |  |
| **主要性能和指标** | 注：请提交产品手册等资料 |
| **本产品的创新性及所获得的知识产权形式** | **已受理专利项数** |  |
| **已获取专利项数** |  |
| 注：如有专利，请注明专利号和专利权人并附证明材料 |
| **本产品的应用市场及销售情况** |  | **销售总额****（单位：万元）** | **销售量****（单位：万颗）** |
| **自产品推出之时起至今** |  |  |
| **2023年全年** |  |  |
| **2024年上半年** |  |  |
| **2024年全年预计** |  |  |
| **市场份额** | （注：根据市场总量实际估测） |
| **对标国外相关芯片产品的情况** | （注：请列出参选产品与国外同类产品在技术参数、国内外市场占有率方面的具体情况对比，最好能体现国外相关产品的具体型号） |
| **本产品的主要客户及应用案例介绍** |  |
| **法律声明：** **申请单位须保证填写内容的真实性及其参加活动产品的合法性，提供相应的证明材料，并承担由内容的真实性及其参加活动产品的合法性的责任。该活动主办方有权追溯取消该申请单位或该产品的一切参与活动的权利，并保留追求其法律责任的权利。**法人/授权代表签名：企业（盖章） 日期： |

**注：本表填写内容仅用于专家评选审阅，不对外公开。**